

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 18 年 5 月 11 日 (2006.5.11)

【公開番号】特開 2004-88093 (P2004-88093A)
 【公開日】平成 16 年 3 月 18 日 (2004.3.18)
 【年通号数】公開・登録公報 2004-011
 【出願番号】特願 2003-188290 (P2003-188290)
 【国際特許分類】

H 0 5 K 3/46 (2006.01)

【F I】

H 0 5 K	3/46	B
H 0 5 K	3/46	N
H 0 5 K	3/46	S
H 0 5 K	3/46	T

【手続補正書】
 【提出日】平成 18 年 3 月 17 日 (2006.3.17)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0 0 2 6
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【0 0 2 6】

工程 P 3 p においては、押板 1 9 により加えられた圧力を除去して絶縁基板 1 1 a を冷却することにより、導体 1 2 a が埋設されると共に表面が平坦化された絶縁基板 1 1 a が得られる。結果、導体 1 2 a が埋設された絶縁基板 1 1 a の表面は所定の平面度 S を有すると共に、絶縁基板 1 1 a の受台 1 8 との当接表面に対して所定の平行度 P を有する。なお上述の押板 1 9 における平面度 S' および平行度 P' は、導体 1 2 a が埋設された絶縁基板 1 1 a の表面における平面度 S および平行度 P が次式 (1) および (2) をそれぞれ満たすように選択される。

$$S < 10 \mu\text{m} \quad \cdots \quad (1)$$

$$P < 10 \mu\text{m} \quad \cdots \quad (2)$$

さらに好ましくは、 $S < 5 \mu\text{m}$ および $P < 5 \mu\text{m}$ である。